

積層セラミックコンデンサ市場における知財覇権：村田製作所の特許報奨制度改定とグローバル競争戦略

Gemini 3.1 pro

1. 序論：テクノロジー覇権と知的財産戦略の交差点

2026年5月13日付の日本経済新聞電子版は、世界の電子部品市場において約40%という圧倒的なトップシェアを握る村田製作所が、自社の従業員に対する特許報奨金を過去10年間で2.5倍に引き上げた事実を報じた¹。この決定は、単なる一企業の人事制度の改定や福利厚生の拡充といった矮小な枠組みで捉えるべきものではない。それは、激化する米中技術覇権競争、グローバルサプライチェーンの再構築、そして人工知能(AI)や電気自動車(EV)といった次世代メガトレンドを背景とした、高度な地政学的・技術的防衛戦略の中核を成すアクションとして位置づけられる。

現代のハイテク産業において、ハードウェアの性能は極限まで追求されており、リバースエンジニアリングによる物理的な技術の模倣リスクはかつてないほどに高まっている。このような環境下において、特許は単なる法的権利であることを超え、競合他社の市場参入を阻止し、高収益なハイエンドセグメントにおける価格決定力を維持するための絶対的な「堀(モート)」として機能する²。

村田製作所の特許報奨制度の大幅な拡充は、中国の国家資本を背景とした技術追いつき戦略や、韓国・サムスングループ(特にサムスン電機)による猛烈な設備投資と特許網の構築に対する、明確かつ攻撃的なカウンターメジャーであると言える⁴。同時に、日本政府が推し進める経済安全保障上の機微技術流出防止策とも軌を一にするものであり、優秀なエンジニアを自社の知的財産創出の「ステークホルダー」として社内に強固に留め置くためのリテンション戦略でもある²。

本レポートでは、村田製作所の特許報奨制度の具体的な変遷と改定の意図を解剖するとともに、積層セラミックコンデンサ(MLCC)および高周波(RF)フィルター市場における競争環境の構造的変化を網羅的に分析する。さらに、中韓の主要競合メーカーの知的財産戦略、日韓のトップ企業間で繰り広げられるクロスライセンス交渉の舞台裏、そして職務発明を取り巻く各国法制度の比較を通じて、知財が企業価値の最大の源泉となる次世代の技術覇権競争の全貌を浮き彫りにする。

2. 村田製作所の特許報奨制度の詳細と戦略的意図

2.1 報奨制度の変遷と「2.5倍」のスケール

村田製作所は2015年度を基準として、直近の10年間で社内の特許報奨金を2.5倍に引き上げるという大胆な制度改定を実施した²。この拡充プログラムの中心にあるのは、市場競争力の強化や他社からのライセンス収入に直接的に結びつくような、極めて価値の高い特許を発明した従業員に対する巨額の金銭的インセンティブである。具体的には、そうした画期的な発明に対しては最大で100万円に達する報奨金が支給される仕組みが構築されている⁴。

日本の伝統的な製造業においては、長年にわたり年功序列型の賃金体系やチーム主義が維持されており、個人の傑出した発明に対して突出した巨額の金銭的インセンティブを付与することは、組織内の調和を乱すという懸念から敬遠される傾向にあった。しかし、村田製作所はこの伝統的なパラダイムから完全に脱却し、実力主義（メリットベース）による金銭的評価を積極的に導入した²。これは、同社が日本の大企業の中でも特異な「アウトライヤー」として、個人の技術的ブレイクスルーを直接的に企業のグローバル競争優位性と結びつける、欧米型のタレントマネジメントおよび知財戦略へと大きく舵を切ったことを示唆している。

さらに特筆すべきは、2023年度（2024年3月期）から導入された「出願前報奨（出願前インセンティブ）」の仕組みである⁴。従来、多くの日本企業の職務発明規程においては、特許庁への「出願時」および「登録時」、そして自社製品への搭載や他社へのライセンス供与を通じた「実績（実施）時」という3段階で報奨金が支払われるのが一般的であった。しかし村田製作所はこれに加えて、特許出願の書類が作成される前の段階であっても、将来の技術標準を決定づけると見込まれる有望な技術アイデアを創出した段階でインセンティブを前倒しで付与する制度を新設したのである。この制度は、研究開発の初期段階から知財化を強く意識した活動をエンジニアに促し、埋もれがちなアイデアを迅速に特許ポートフォリオへと組み込むための極めて強力なポンプとして機能している。

村田製作所の特許報奨制度における戦略的進化



2015年を基準とした10年間で、特許報奨の総額規模は2.5倍へと急拡大した。特に2023年度の「出願前インセンティブ」の導入は、研究開発の初期段階からの知財創出を促すパラダイムシフトを示している。

Data sources: [Futunn](#), [BigGo](#) (The Nikkei)

2.2 量から質への転換：特許の「網」と「堀」の構築

村田製作所の経営陣、特に中島規巨社長を中心とする首脳陣は、独自のコア技術こそが市場における圧倒的な地位の基盤であると繰り返し強調してきた⁶。この報奨金引き上げの背景にあるのは、単なる特許出願件数の増大（ボリュームの追求）ではなく、競合他社が法的に回避不可能な「質」の高い特許網の構築である。

積層セラミックコンデンサ（MLCC）の製造には、誘電体材料のナノレベルでの微細化、均一な極薄シートの成形、そして高度な温度管理を伴う焼成プロセスといった、長年の経験に基づく「暗黙知」や「すり合わせ技術」が不可欠であるとされてきた。しかし近年、製造装置の汎用化が進み、さらに中国政府による国家資本の継続的な注入により、新興メーカーによる技術のキャッチアップ速度は劇的に向上している²。そのため、村田製作所はノウハウとして社内のブラックボックスに秘匿すべき技術と、特許として公開し明確に権利化することで他社を牽制する技術の切り分けを、これまで以上に

厳格かつ戦略的に行っている。

同社のエンジニアに対しては、目先の些末な設計課題を解決することのみに留まらず、5年後、あるいは10年後の電子部品業界の標準を定義づけるような根本的な特許を生み出すことが強く求められている²。これは、一つの画期的な基本特許(コアパテント)の周囲に、無数の改良特許や用途特許、周辺特許を緻密に張り巡らせる「特許の網(パテント・チケット)」を構築する戦略に他ならない。優れた技術アイデアを次々と特許化して網を編み上げることで、競合他社は村田製作所の知財に抵触せず同等以上の性能を持つ製品を設計することが、物理的かつ法的に極めて困難になる。巨額の報奨制度は、この法的な「堀(モート)」をより深く、より広範にするための最も有効な組織的ツールとして機能しているのである²。

3. MLCC市場の構造変化と知財の重要性

特許報奨がこれほどまでに重視され、多額の投資が行われる理由は、村田製作所の主戦場であるMLCC市場がかつてない規模の「スーパーサイクル」に突入しており、そこから得られる莫大な利益を保護する必要があるからである。MLCCは、電子回路において電気を蓄えたり放出したりすることで電圧を安定させ、ノイズを除去する「電子産業の米」とも呼ばれる不可欠な受動部品である²。

3.1 メガトレンドによる需要の爆発

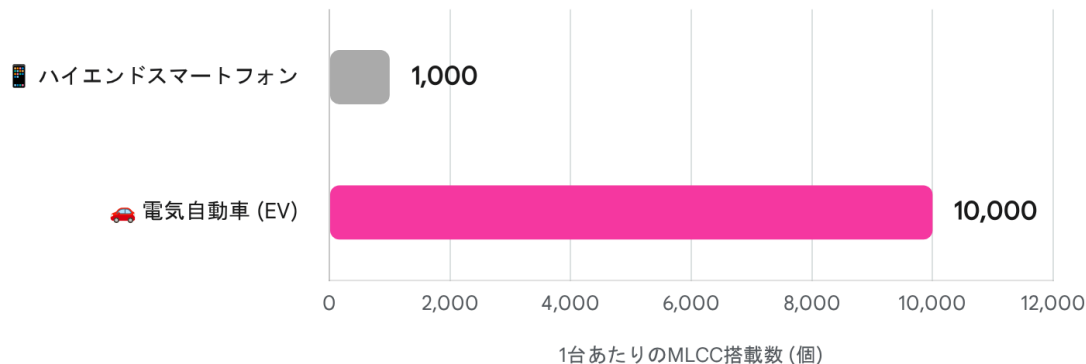
近年、電子部品市場を取り巻く以下の3つのメガトレンドが、高性能MLCCの需要を爆発的に牽引している。

第一の牽引力は、自動車の電動化(EV)と先進運転支援システム(ADAS)の普及である。従来の内燃機関車におけるMLCCの搭載数は数千個程度であったが、高度な電子制御ユニット(ECU)と巨大な駆動用バッテリーを搭載する最新の電気自動車(EV)には、1台あたり実に1万個以上のMLCCが使用されると推定されている²。自動車向け部品は、極端な温度変化や激しい振動に耐えうる極めて高い信頼性(AEC-Q200等の厳格な車載規格への準拠)が要求されるため、技術的ハードルが最も高い。同時に、一度採用されれば顧客である自動車メーカーやTier-1サプライヤーが容易には部品を変更しない「粘性」の高い市場であり、非常に高い利益水準を享受できるセグメントとなっている。

第二の牽引力は、5G/6Gといった次世代通信規格の普及とスマートフォンの高度化である。5G対応のハイエンドスマートフォン1台には、より複雑化するRF(高周波)回路や高度な電源管理回路が限られたスペース内に高密度で実装されるため、1,000個を超える超小型・大容量のMLCCが詰め込まれている²。ここでは、信頼性に加えて極限までの小型化・薄型化の技術が問われており、特許による技術の囲い込みが直接的に製品シェアを左右する。

第三の牽引力は、AIサーバーとデータセンターの急拡大である。生成AIの爆発的な普及に伴い、巨大IT企業(ハイパースケーラー)からのAIサーバー向け投資が急増している。AIサーバーに搭載される最先端のGPUやプロセッサは、従来のサーバーと比較して桁違いの電力消費と熱処理を伴う。そのため、大容量の電力を瞬時に安定供給でき、かつ高温環境下でも長期間安定して稼働するハイエンドMLCCが大量に消費される。村田製作所の中島規巨社長は、主要なクラウドプロバイダーによる強固なデータセンター投資が今後3年から5年は継続すると予測しており、同社のMLCCに対する顧客からの問い合わせは、現在利用可能な供給能力の約2倍に達していると述べている⁴。

次世代デバイスにおけるMLCC（積層セラミックコンデンサ）搭載数の劇的な増加



ハイエンドスマートフォン1台あたりの搭載数が約1,000個であるのに対し、先進運転支援システム（ADAS）を搭載した電気自動車（EV）では1万個を超すMLCCが消費される。この自動車向けハイエンド市場の覇権が、各社の知財戦略の主戦場となっている。

データソース: [The Nikkei](#)

3.2 供給不足と価格決定力

このような複数のメガトレンドが重なり合った結果として生じる需要増に対し、MLCC市場は逼迫の度合いを強めている。報道によれば、AIサーバーや電気自動車セクターからの強い需要を背景に、MLCCの平均販売価格は上昇基調にあり、サプライチェーン関係者は4月以降に二桁台のパーセンテージに達する価格引き上げが行われる可能性を指摘している⁶。

村田製作所が40%の圧倒的シェアを維持し、この強気な価格交渉力（プライシングパワー）を保持するためには、特許という強力な「盾」によって後発メーカーの低価格品による市場浸食を水際で防ぐことが絶対条件となる。知的財産の強化は、単なる法務リスクの低減ではなく、直近の売上総利益率（マージン）の維持・向上に直結する極めて直接的な財務戦略でもあるのだ⁶。

さらに、セラミックベースのMLCCは、超薄型プロファイルと高温安定性を誇る「シリコンキャパシタ（シリコンコンデンサ）」という新たな破壊的技術からの脅威にも直面している⁸。ウェアラブル端末や最先端の光モジュール市場において、シリコンキャパシタは従来のMLCCのニッチな領域を侵食しつつある。こうした次世代技術へのパラダイムシフトが起こる中で、村田製作所は既存のMLCC技術の延命だけでなく、将来の代替技術を見据えた先行的な知財確保を迫られており、それが特許報奨の劇的

な増額を後押ししている。

4. 競合環境の変遷と中韓メーカーの追及

村田製作所の背後には、豊富な資金力と国家的な支援を背景にした新興勢力が迫っている。競合他社は単なる規模の拡大だけでなく、知財ポートフォリオの構築においても村田製作所を猛烈にキャッチアップしようとしている。主要なプレーヤーとしては、韓国のサムスン電機(Samsung Electro-Mechanics)、日本の太陽誘電やTDK、台湾のYageo(国巨)やWalsin、そして米国のKyocera AVXやVishayなどが挙げられる⁸。

4.1 中国メーカーの台頭と特許出願の急増

中国の国家資本主義を背景に急速に技術力を高める中国メーカーの台頭は、既存メーカーにとって最大の長期的脅威である。中国政府は「中国製造2025」などの産業政策を通じ、半導体や重要電子部品の自給自足(国産化)を強力に推進している。これに伴い、無尽蔵とも言える国家補助金が投下され、製造設備の高度化と海外からの人材引き抜きが行われてきた²。

結果として、中国メーカーは低価格帯の汎用MLCCコンポーネントの生産量を劇的に増加させているだけでなく、近年では自社技術の保護と海外市場への参入を見据え、特許出願件数を急激に増加させている⁴。彼らはかつてのように他社特許を侵害して安価に製造する段階から脱却し、独自の特許網を構築して法的にも武装する段階へと進化しつつある。この知財の地政学的シフトこそが、村田製作所が防衛の壁を急激に高くせざるを得なかった最大の要因である。

4.2 サムスン電機の野心とオープン知財戦略

一方、ハイエンド市場において村田製作所の最大のライバルとなっているのが、韓国のサムスン電機(Samsung Electro-Mechanics: SEMCO)である。サムスン電機は、スマートフォンやPC向けのIT用途MLCCにおいては継続的な研究開発と設備投資により村田製作所との技術格差を大きく縮小させてきた。しかし、最も高い収益性と将来の成長性が見込める車載向け(Auto-component MLCC)においては、依然として市場シェアが一桁台にとどまっており、村田製作所、TDK、太陽誘電といった日本勢の厚い壁に阻まれているのが現状である¹⁰。

これに対し、サムスン電機のKyung Kye-hyun CEOは、2022年までに車載向けで世界第2位のシェアを獲得し、2025年にはIT向けを含めたMLCC市場全体で世界首位を奪取するという極めて野心的な目標を掲げていた¹¹。この目標を達成するため、同社は高付加価値製品へのシフトを進め、生産能力の倍増に向けた巨額の設備投資(Capex)を行っている。

さらに特筆すべきは、サムスン電機が自社のエコシステムを強化するために取り入れた独自の知財戦略である。2026年4月に開催された「Mutual Growth Cooperation Day」において、サムスン電機のChang Duck-hyun CEOは、サプライチェーンの競争力強化の一環として、主要パートナー(サプライヤー)に対して自社の特許ポートフォリオを無償で開放する方針を発表した¹²。このアプローチは、特許を独占的な「堀」として利用して他社を排斥しようとする村田製作所のクローズドなアプローチとは対照的である。サムスン電機は、特許を開放することで素材や製造装置のサプライヤーの技術革新を底上げし、サプライチェーン全体のコスト競争力と品質を向上させるという、エコシステム主導の「オープン戦略」へと舵を切っている。

以下の表は、村田製作所とサムスン電機の競争戦略および知財アプローチの根本的な違いを要約したものである。

比較項目	村田製作所 (Murata Manufacturing)	サムスン電機 (Samsung Electro-Mechanics)
グローバル市場シェア (MLCC全体)	約40%(世界首位・圧倒的防衛) ²	世界第2位(村田を猛追・シェア奪取へ攻勢)
強みとするセグメント	車載向け(AEC-Q200準拠)、5G、高周波モジュール	IT向け(スマホ、PC)、AI向け高付加価値品へのシフト
近年の知財戦略・報奨の動き	過去10年で特許報奨金を2.5倍へ増額。最大100万円。出願前報奨導入。 ²	パートナー(サプライヤー)への自社特許ポートフォリオの開放を2026年から開始 ¹² 。
法的・権利行使のスタンス	中国市場での訴訟件数増大(10件以上)など積極的かつ排他的な権利行使へ転換 ⁴	親会社のサムスン電子に追随し、内部の特許出願報奨金を大幅に引き上げる方向性 ¹³ 。

5. 日韓トップ企業の特許報奨競争とクロスライセンス交渉

村田製作所が特許報奨金を2.5倍に引き上げた背後には、サムスン電機を擁するサムスングループ全体の知財戦略の劇的な変化と、水面下で進行する熾烈なクロスライセンス交渉が存在する。

5.1 サムスン電子における特許報奨金の「3倍」引き上げ

サムスングループにおける知財強化の波は、部品メーカーであるサムスン電機にとどまらない。グループの中核であり、グローバルテクノロジーの巨人であるサムスン電子もまた、直近で従業員の特許出願に対する報奨金を従来の最大3倍に引き上げるという異例の大規模な措置を講じている¹³。

この新制度は2027年9月までの2年間適用される時限的な強化策であり、社内の士気を高め、先端メモリ、ファウンドリ(半導体受託製造)、テレビ、そしてスマートフォン向けアプリケーションプロセッサ(AP)といった同社の基幹事業領域における新技術の開発を猛烈に促進することを目的としている¹³。

制度の詳細によれば、特許はその重要度や出願国に応じて「A1」「A2」「B」などの等級に分類される。すべての主要海外国に出願される最高ランクの「A1」特許に対する報奨金は、従来の100万ウォンから150万ウォンに引き上げられた。米国または中国に出願される「A2」特許については、50万ウォンから100万ウォンへと倍増している¹³。注目すべきは、サムスン電子は2017年以前は最高ランクの特許であっても一律50万ウォンしか支給しておらず、実に約10年ぶりとなる抜本的な増額であ

る点だ。

さらにサムスン電子の制度でエンジニアにとって極めて魅力的なのは、特許出願時の一時的な報奨金に加えて、その特許が組み込まれた製品の市場における地位や販売量(売上規模)に基づいて算出される「月額ロイヤリティ(実績報奨)」が所定期間にわたって継続的に支払われる点である¹³。また、同社は全従業員を対象とした長期的な報酬体系として、自社株の付与(Stock-based awards)を導入し、従業員の財産的利益を会社の株価に直接連動させる施策も発表している¹⁴。年間10件以上の特許を出願するような優秀なトップエンジニアにとって、この増額と株式報酬の組み合わせは、村田製作所の最大100万円の報奨制度にも匹敵、あるいは凌駕する巨大なインセンティブとなる。

かつて「テクノロジー・オタク」と称されるほど圧倒的な技術優位性を誇りながら、近年では競合との熾烈な技術競争に晒されているサムスン電子が、村田製作所と歩調を合わせるように知財インセンティブを強化している事実は、日韓のトップ企業間で「エンジニアの頭脳」を巡る果てしない投資競争が勃発していることを証明している。

5.2 村田製作所 vs サムスン電機: 車載MLCCを巡る特許外交

特許報奨金の増額によって蓄積された知財ポートフォリオは、企業間の直接的なアライアンスや契約交渉において最大の武器となる。サムスン電機と村田製作所の間には、特許を巡る長く複雑な因縁が存在し、現在その関係性は新たな局面を迎えている。

2011年、サムスン電機は米国国際貿易委員会(ITC)において村田製作所との間で繰り広げられた特許侵害訴訟に勝利するという歴史的な出来事があった¹⁰。この訴訟を契機として、双方は泥沼の法廷闘争を回避し、共存を図るために、2012年にMLCC関連特許の広範なクロスライセンス契約(相互のライセンス料の支払いを事実上無償とする取り決め)を締結した¹⁰。以降10年以上にわたり、両社はこの契約を定期的に更新し、比較的安定した競争関係を維持してきた。

しかし、市場のパラダイムが「IT」から「車載(Auto-component)」へとシフトする中で、このパワーバランスは崩れつつある。前述の通り、サムスン電機は車載向けMLCC事業を急拡大させようとしているが、自社の知財ポートフォリオだけでは、車載特有の高い信頼性要件(AEC-Q規格など)を満たす技術を網羅できていない¹⁰。サムスン電機が市場シェアを拡大するためには、既存のクロスライセンスの枠組みではカバーしきれない、村田製作所が保有する最先端の車載向け特許に対する権利を何としても確保する必要がある。もし村田製作所の知財を合法的に利用できなければ、サムスン電機はTDKや太陽誘電といった他の日本メーカーからの特許訴訟リスクに無防備な状態で直面することになる。

ここにおいて、村田製作所が社内の特許報奨を強化し、次世代の車載・AI向け特許を競合に先んじて大量かつ網羅的に確保しておくことの真の価値が発揮される。更新時期を迎えるクロスライセンス交渉において、村田製作所は圧倒的に有利な立場に立つことができる。村田製作所は、過去10年間無償であったライセンス契約を見直し、サムスン電機に対して莫大なライセンスフィー(特許使用料)を要求する戦略に出るか、あるいは自社の競争優位性の源泉となる特定のコア特許をクロスライセンスの対象から除外することで、サムスンの車載市場への参入自体を遅らせるという選択を取ることができる¹⁰。

このように、特許報奨制度を通じて社内から生み出される技術的ブレイクスルーは、単なるカタログスペックの向上に留まらず、競合他社の経営戦略を直接的に制約し、あるいは莫大な不労所得(ラ

イセンス収入)をもたらす「外交カード」として機能するのである。

6. 職務発明を巡る各国の法制と訴訟リスクのマネジメント

グローバルな知財競争を勝ち抜くためには、自国の法制に基づく職務発明の取り扱いを最適化し、事後的な訴訟リスクを最小化する法務戦略が不可欠である。村田製作所の制度改定は、日本国内の法改正の方向性とも完全に軌を一にしており、他国の法制度の不確実性を反面教師とした合理的判断の結果でもある。

6.1 韓国における職務発明訴訟の巨額化と潜在リスク

サムスングループが特許報奨金を青天井に引き上げざるを得ないもう一つの切実な理由が、韓国国内における「職務発明補償金請求訴訟」の巨額化リスクである。韓国では、企業の退職者が自らの発明に対する正当な対価が支払われていないとして、古巣に対して天文学的な金額の訴訟を提起する事例が相次いでいる。

例えば、アップル社との特許訴訟において重要な役割を果たした元研究員(マルチアクセス通信システムの伝送速度エンコード技術などを発明)が、自らの特許がアップルに対する勝訴と会社の利益に多大な貢献をしたにもかかわらず、発明者の名前も正當に評価されず、十分な補償も受けていないとして、50億ウォン(約5億円)規模の訴訟に発展したケースがある¹⁵。

さらに別の衝撃的な訴訟では、PLS(Plane to Line Switching)モードLCD製品に関連する職務発明を巡り、元従業員がサムスン電子に対して約660億ウォン(約66億円)という途方もない額の補償を求めた¹⁶。原告側は、その特許が製品売上(約27兆ウォン)に貢献した割合や、仮想的なロイヤリティレート(Hypothetical royalty rate)、さらには発明者の貢献度などを複雑に掛け合わせた独自の計算式を根拠に巨額の請求を行った。最終的に裁判所が命じた支払額は約4,800万ウォンと大幅に減額されたものの、企業側にとってこのような訴訟の頻発は、莫大な弁護士費用、法務部門の疲弊、そして「発明に報いない企業」という重大なレピュテーションリスクをもたらす¹⁶。

また、韓国の最高裁判所は、職務発明補償金の消滅時効(10年)の起算点について、現行の規程ではなく「従業員が在職し、発明を行った当時の規程」を基準に計算すべきとの厳格な判断を下しており、企業側の潜在的な負債(Remuneration liabilities)リスクは長期間にわたって消滅しないという厄介な問題を抱えている¹⁷。

このように、事後的な巨額訴訟のリスクを回避しつつ、優秀な人材の競合他社への流出を防ぐためには、あらかじめ社内の特許報奨・補償制度を公明正大かつ極めて手厚くし、発明時点から十分な経済的利益を還元する仕組みを構築することが、現代の経営における防衛策の基本となっている。村田製作所の2.5倍の引き上げも、こうしたグローバルでの人材獲得競争と法務リスクマネジメントの文脈の中で捉える必要がある。

6.2 日本における特許法第35条の改正と「相当の利益」の追求

ひるがえって日本の法制度を見ると、村田製作所の報奨制度改定は、国家の法改正の趣旨を先取りし、最大限に活用するものであることがわかる。

日本の特許法第35条(職務発明)は、長らく「発明は原則として従業員(発明者)に帰属する」という建前をとっており、企業は従業員から特許を受ける権利を譲り受ける代わりに「相当の対価(

Remuneration)」を金銭で支払う義務を負っていた。しかし、青色発光ダイオード(LED)訴訟に代表されるような、退職した元従業員からの予見不可能な巨額訴訟リスクに対する産業界からの強い懸念を受け、2015年(平成27年)に大規模な法改正が行われ、2016年4月に施行された¹⁹。

新特許法の下では、企業があらかじめ契約や職務発明規程などで定めておけば、特許を受ける権利を「原始的に(発生と同時に)」法人(使用者)に帰属させることが可能となった¹⁹。同時に、従業員に支払われるべき報酬は、金銭(対価)に限定されないストックオプションや留学機会なども含む「相当の利益(Reasonable economic profits)」という広範かつ柔軟な概念へと変更された¹⁹。

さらに経済産業省・特許庁は、新たな制度の下で企業が支払う利益が不合理なものでないかを判断するために、労使間の協議手続きの妥当性(手続きの不合理性がないか)を重視する詳細なガイドラインを策定した¹⁹。村田製作所による最大100万円への上限引き上げと、出願前インセンティブの導入は、この「手続きの妥当性」と「相当の利益の付与」を極めて高いレベルで満たすものであり、将来的な従業員からの訴訟リスクを根絶しつつ、特許権の会社への原始的帰属を盤石なものにするための、極めて洗練された法務戦略であると言える。

7. 「盾」から「矛」へ: 積極的な権利行使とグローバル訴訟戦略

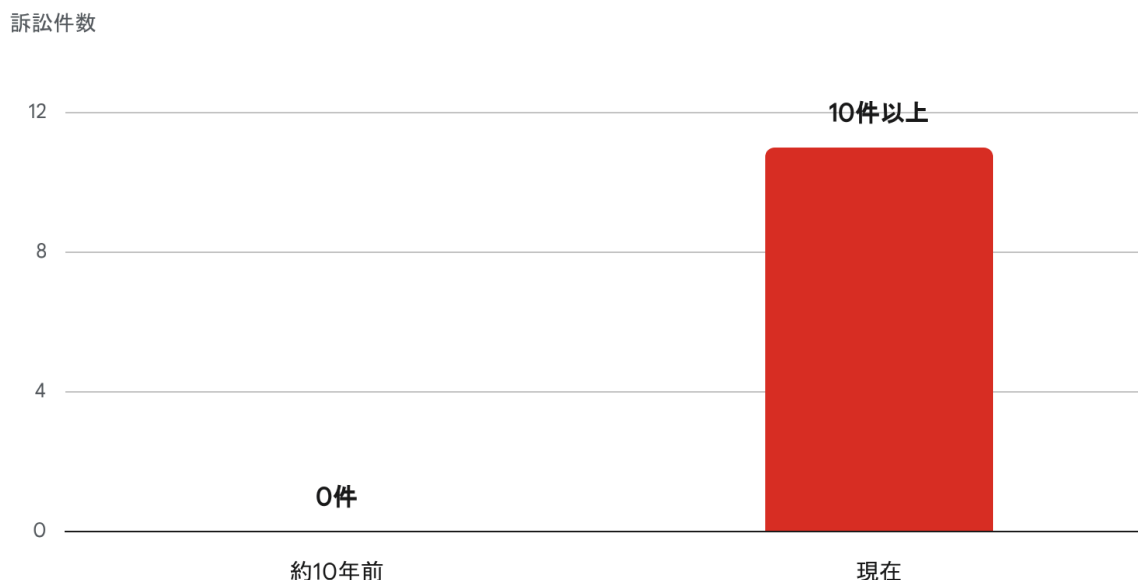
報奨制度によって積み上げられた高品質な特許群は、単なる金庫の中の資産ではない。村田製作所は近年、この知財ポートフォリオを「市場への新規参入を阻止する障壁(矛)」として、実戦で積極的に行使(Weaponizing)し始めている²。

7.1 中国市場における積極的な法的包囲網の形成

かつて、日本の製造業の多くは特許を「他社から訴えられた際のクロスライセンス用の防衛的カード(盾)」として保有する傾向が強く、自ら積極的に訴訟を提起することは経営リソースの浪費として嫌われる傾向にあった。しかし、村田製作所はその姿勢を大きく転換している。

『日本経済新聞』の報道が指摘するように、村田製作所は過去10年前には中国での特許訴訟をほとんど抱えていなかったにもかかわらず、現在では中国国内で10件以上の特許侵害訴訟の当事者として積極的に法的権利を行使している⁴。さらに同社は北米での知財オペレーションも大幅に拡大しており、テキサス州東部地区連邦裁判所(Chief Judge Rodney Gilstrapが担当)におけるModulus SystemsからのRFモジュール技術(US8610573B2)に関する特許侵害訴訟など、米国におけるハイステークスな法廷闘争にも十分なリソースを割いて対応している²¹。

村田製作所による中国での特許侵害訴訟件数の推移



10年前は皆無であった中国国内における特許訴訟が、現在では10件以上同時進行している。これは、同社が知的財産を「防衛の盾」から「市場防衛のための武器」へと転換させた証左である。

データソース: Futunn (Nikkei)

7.2 ケーススタディ: Maxscend Microelectronicsに対するTF-SAW特許訴訟

村田製作所の「盾から矛へ」の積極的な訴訟戦略を最も象徴的に示しているのが、中国の急成長RFフロントエンドメーカーであるJiangsu Maxscend Microelectronics (卓勝微)に対する大規模な特許侵害訴訟である。

スマートフォンの通信品質を決定づけ、不要な信号周波数をフィルタリングする高周波(RF)フィルター市場において、村田製作所は表面弾性波(SAW)フィルター、特に高周波特性に優れた「TF-SAW(Thin-Film Surface Acoustic Wave)」技術で世界をリードしている。TF-SAWは特定のアプリケーションにおいてBAW(Bulk Acoustic Wave)フィルターよりもコスト優位性と性能のバランスに優れている²²。Maxscendが自社のTF-SAW製品(MAX-SAW)の商業化フェーズに入り、世界のサプライチェーンに食い込み始めた段階で、村田製作所は中国(上海知的所有権法院)、韓国、ドイツという主要な3つの管轄区域にまたがり、一斉に訴訟を提起した²²。

この訴訟で村田製作所が主張している特許(中国でのZL201680046210.1など)は、単なる嫌がらせではなく、極めて緻密に構築された「多層的(Multi-Layered)」な特許網に基づいている²³。単一のデバイスの特徴や局所的な製造プロセスの詳細を狙い撃ちにするのではなく、以下の3つの抽象度で網羅的に特許を押さえている点が村田製作所の知財戦略の神髄である。

1. スタックアップ構造設計 (**Stack-up structure design**): デバイスの多層構造そのものの物理的配置に関する特許。
2. 共振器レベルの横モードエンジニアリング (**Resonator-level lateral mode engineering**): 高次モードの不要波(スプリアス信号)を抑制するための微細な内部構造に関する特許²²。
3. フィルターシステム全体のアーキテクチャ (**Filter system architecture**): 回路全体としての構成に関する特許。

このように、部品のミクロな内部構造から、機能、そしてシステム全体への統合というすべての階層で特許を取得しておくことで、競合他社は一部の設計を迂回できたとしても、必ず別の階層の特許に抵触することになり、事実上製品の製造・販売が不可能となる。特に、Maxscendにとって最大の顧客層が存在するサムスン電子のお膝元である韓国で訴訟を展開する手法は、競合のサプライチェーン全体に対して強烈的な牽制とプレッシャーをかける高度な法的戦術である²²。

村田製作所が特許報奨金を2.5倍に引き上げた真の狙いは、まさにこうした「他社に回避不可能な多層的特許網」を構築するための、質の高い発明を社内から継続的に生み出すエコシステムを維持することにある。ハードウェアの製品自体は分解してリバースエンジニアリングすることが可能であっても、これら多重に張り巡らされた特許の網(法的モート)は、競合のR&D投資を無力化し、市場参入を何年にもわたって遅らせる絶対的な防壁となる²。

8. 環境・サステナビリティ戦略との統合

また、村田製作所の知財・技術戦略は、近年のグローバルなESG(環境・社会・ガバナンス)の潮流とも深く結びついている。製造業に対する環境規制の厳格化に伴い、同社は2026年までに複数の主要拠点で再生可能エネルギー比率を100%にするという高い目標を掲げている⁸。

こうしたグリーンな生産体制への移行は、単なる環境保全活動にとどまらず、ESGを重視する欧米の機関投資家からの評価を高め、サプライチェーンの強靭性を向上させる重要な要素である。特許報奨制度によって奨励される発明の中には、MLCCの製造プロセスにおけるエネルギー効率の劇的な改善や、より環境負荷の低い材料の代替技術なども含まれることが予想される。技術革新を通じた環境目標の達成は、同社のもう一つの「競争の堀」を形成しているのである。

9. 結論: 知財投資が決定する未来の業界地図

村田製作所が直近の10年間で従業員への特許報奨金を2.5倍に引き上げたという事実は、単なる人事制度の充実や福利厚生ニュースとして消費されるべきではない。これは、積層セラミックコンデンサ(MLCC)や高周波モジュールという、現代のあらゆるデジタル・モビリティインフラの心臓部を担うハードウェア市場における、苛烈な知財覇権戦争の宣戦布告に他ならない。

本分析を通じて明らかになった事象とそのインプリケーションは以下の通りである。

第一に、需要の構造的変化への適応と価格決定力の維持である。EVや生成AIサーバーというメガトレンドは、MLCCの必要搭載数を従来の10倍、20倍へと押し上げている。この未曾有のボリュームゾーンにおいて40%のグローバルシェアを維持し、供給逼迫に伴う二桁台の価格引き上げ(プライシングパワー)を行使し続けるためには、単なる製造スケールだけでなく、法的に保護された技術的優位性による「堀」が不可欠である。出願前インセンティブを含む報奨制度の強化は、エンジニアの意

識を目前の改良から、5年後、10年後の規格を支配する「基本特許の創出」へと変革するための触媒となっている。

第二に、中韓メーカーに対する熾烈な牽制と「武器としての知財」の行使である。サムスン電子による特許報奨の最大3倍への引き上げや、サムスン電機による車載MLCC市場への猛追、特許開放というオープン戦略、そして中国政府の巨額な産業補助金に支えられた新興メーカーの台頭は、日本企業の相対的な技術優位を常に脅かしている。これに対し村田製作所は、中国市場での訴訟件数をゼロから10件以上へと急増させ、TF-SAWフィルターの事例に見られるような「多層的な特許の網（パテント・チケット）」を活用して、競合の市場参入を法的に封じ込める戦略へと完全にシフトした。社内の報奨制度拡充は、この終わりのない特許弾薬を絶え間なく供給するための兵站（ロジスティクス）である。また、間近に迫るサムスン電機とのクロスライセンス交渉においても、強固な特許網は莫大なライセンス収入や市場競争の主導権を握るための最大の外交カードとなる。

第三に、法的・経済安全保障的要請への完全な合致である。職務発明に対する巨額の訴訟リスク（韓国における事例など）を未然に防ぐためには、日本の特許法第35条の改正趣旨に則り、「相当の利益」を透明かつ手厚く還元する実力主義のインセンティブシステムが必要不可欠であった。同時に、機微技術とトップエンジニアの海外流出を防ぐという国家の経済安全保障戦略に貢献する意味でも、エンジニアを会社の知財的成功のステークホルダーとして厚遇する戦略は極めて理にかなっている。世界知的所有権機関(WIPO)が指摘するように、テクノロジーの知識の流れが国境を越えて加速し、模倣のスピードが短縮化する「知識経済」の幕開けにおいて、知的財産で武装することは企業の生存条件そのものである²⁴。

結論として、村田製作所の知財戦略は「技術力で勝ち、ビジネスでも勝ち、そして法務でも勝つ」という次世代ハイテク製造業の理想形を体現しようとしている。最大100万円に達する特許報奨への投資は、単なる人件費のコストではなく、将来の莫大なマージンを保証し、競合のR&D投資を無力化し、グローバルな法廷闘争を勝ち抜くための、最も費用対効果の高い防衛予算である。今後、電子部品業界における真の勝者は、工場への莫大な設備投資だけでなく、技術者の頭脳から生み出される知的財産への投資を最大化し、それをグローバルで冷徹に行使できた企業のみが絞られていくことが強く示唆される。

引用文献

1. Japan's Murata rewards in-house innovators to keep global capacitor lead - United Cultures, 5月 16, 2026にアクセス、
<https://unitedcultures.org/news/article/?id=4307>
2. Murata Hikes Patent Rewards 2.5-Fold to Fortify Global MLCC Dominance - BigGo Finance, 5月 16, 2026にアクセス、
<https://finance.biggo.com/news/WY78HZ4BrX5PFN7Bqs4n>
3. patesalo: "村田製作所、社員の特許報奨10年で2.5倍 中韓に対抗で世界..." - patesadon, 5月 16, 2026にアクセス、
<https://patesadon.com/@patesalo/116563475160936727>
4. Market Chatter: Murata Expands Patent Incentives to Defend MLCC Lead - 富途资讯, 5月 16, 2026にアクセス、
<https://news.futunn.com/en/post/72977507/market-chatter-murata-expands-patent-incentives-to-defend-mlcc-lead>

5. "Yuki Murata" Related News - BigGo Finance, 5月 16, 2026にアクセス、
<https://finance.biggo.com/s/Yuki%20Murata>
6. [News] Samsung Electro-Mechanics Reportedly Weighs Double-Digit MLCC Price Hike in April Amid AI Demand - TrendForce, 5月 16, 2026にアクセス、
<https://www.trendforce.com/news/2026/02/24/news-samsung-electro-mechanics-reportedly-weighs-double-digit-mlcc-price-hike-in-april-amid-ai-demand/>
7. 2026 Patent 300 List, 5月 16, 2026にアクセス、<https://harrityllp.com/patent300/>
8. What is Competitive Landscape of Murata Manufacturing Company? - Matrix BCG, 5月 16, 2026にアクセス、<https://matrixbcg.com/blogs/competitors/murata>
9. What is Competitive Landscape of Murata Manufacturing Company? - Porter's Five Forces, 5月 16, 2026にアクセス、
<https://portersfiveforce.com/blogs/competitors/murata>
10. Samsung Electro-Mechanics to secure auto-component MLCC patents - The Elec Inc., 5月 16, 2026にアクセス、
<https://www.thelec.net/news/articleView.html?idxno=1597>
11. Samsung Electro-Mechanics extends MLCC patent contract with Murata, 5月 16, 2026にアクセス、<https://thelec.net/news/articleView.html?idxno=2521>
12. Samsung Electro-Mechanics Hosts 2026 Partner Day, Expands Support Programs, 5月 16, 2026にアクセス、
<https://www.thelec.net/news/articleView.html?idxno=10067>
13. Samsung Electronics Triples Employee Patent Compensation - Businesskorea, 5月 16, 2026にアクセス、
<https://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=256044>
14. Samsung ties employee payouts to stock price in first company-wide incentive program, 5月 16, 2026にアクセス、
<https://www.techspot.com/news/109857-samsung-ties-employee-payouts-stock-price-first-company.html>
15. Samsung researcher sues company over compensation for patents - The Korea Herald, 5月 16, 2026にアクセス、<https://www.koreaherald.com/article/1523773>
16. Korean Court Denies Bulk of Samsung Ex-Employee's Multi-Billion Won Inventor Compensation Claim - Kim & Chang, 5月 16, 2026にアクセス、
https://www.kimchang.com/newsletter/20160819/en/newsletter_ip_en_summer_fa112016_article09.html
17. 17年前に退社したサムスン電子の研究員が会社を相手に起こした職務発明補償金請求訴訟で, 5月 16, 2026にアクセス、<https://www.mk.co.kr/jp/business/11048918>
18. The Supreme Court has ruled that when a former Samsung employee belatedly claims compensation for an employee invention, the payment should be assessed based on the regulations in effect at the time of their employment - 알파경제, 5月 16, 2026にアクセス、<https://alphabiz.co.kr/news/print.html?newsid=107466>
19. Revisions Made to the Japan Patent Law Relating to Employee Invention System (made effective on April 1, 2016), 5月 16, 2026にアクセス、
https://www.seiwapat.jp/en_ip.assets/en00029_Employee%27s_Inventions_Reform.pdf
20. Japan Patent Office, 5月 16, 2026にアクセス、
https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/shutugan/syokumu/document/index/case_

[studies.pdf](#)

21. Modulus Systems v. Murata Electronics — RF Module Patent Dispute - PatSnap, 5月 16, 2026にアクセス、
<https://www.patsnap.com/resources/blog/litigation/modulus-systems-v-murata-electronics-rf-module-patent-dispute-patsnap/>
22. TF-SAW Patent Disputes Intensify as Murata Sues Maxscend - ALLPCB, 5月 16, 2026にアクセス、
<https://www.allpcb.com/allelectrohub/tfsaw-patent-disputes-intensify-as-murata-sues-maxscend>
23. Murata's Patent Lawsuit Against Maxscend: From Shanghai, Seoul to Munich - Understanding the TF-SAW Dispute - Murata Manufacturing Co., Ltd. - EEWORLD, 5月 16, 2026にアクセス、
<https://en.eeworld.com.cn/news/manufacture/eic716334.html>
24. World Intellectual Property Report 2026: Technology on the Move - WIPO, 5月 16, 2026にアクセス、
<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-944-2026-en-the-world-intellectual-property-report-2026-technology-on-the-move.pdf>